

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年6月)

编号：2023-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	易方达基金、天弘基金、中银基金、建信基金、南方基金、博时基金、国寿安保基金、安信基金、九泰基金、朱雀基金、民生加银基金、融通基金、华夏未来资本、光大永明资产、源乐晟资产、恒越基金、泰德圣投资、尚雅投资、山楂树资产、广发资管、长江资管、国金资管、海通证券、中信证券、中金公司、中银证券、光大证券、兴业证券、中邮证券、银河证券、浙商证券、东北证券、西部证券、山西证券、开源证券、华金证券。
活动时间	2023年6月1日—2023年6月30日
活动地点	公司会议室、线上会议系统
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理 郑瑞俊 副总经理 林文浩 董事会秘书 奚颢 财务总监 闫柳 证券事务代表 王赞

投资者关系活动主要内容介绍

1、问：公司上半年整体情况如何？预计下半年订单及下游需求趋势情况如何？

答：Q1 情况整体与 2022 年 Q4 基本持平，自 2023 年 3 月起订单情况有所转暖，稼动率快速回升，具体请参见公司后续公告及定期报告。

从显驱芯片由中国台湾向中国大陆产业转移的大趋势来看，对 Q3、Q4 整体保持谨慎乐观预期，Q3、Q4 已有部分订单覆盖，稼动率大幅向下波动可能性较小。

2、问：近期 TDDI 等芯片价格波动是否会对公司业务价格造成不利影响？

答：TDDI 等芯片价格波动可能会影响客户下单，对业务价格影响不大，公司封测业务价格长期来看基本稳定，受芯片短期价格波动的影响较小。公司已通过优化产品结构及产能配置应对相关品类芯片的周期波动。

公司具备良好的抗周期意识和应对周期波动的措施，一方面及时重点布局高阶产品，通过优化产品结构平滑盈利周期；另一方面保持相对稳健的扩产节奏，不盲目扩产比拼产能规模，平滑增长曲线。

3、问：除现有显示驱动芯片封测业务外，公司对其他领域的芯片封测业务是否有布局？

答：现阶段受限于产能，公司主要聚焦于显示驱动芯片的封测业务，对于非显业务正在进行积极的布局和人才团队建设。

4、OLED 与 LCD 的驱动芯片在封测环节有哪些主要差异？不同线宽的芯片对封测工艺有不同的影响吗？

答：在显驱芯片领域，不同线宽芯片对封测工艺的要求

	<p>相差不大，高阶制程对测试环节要求更高，目前显驱芯片主流应用的制程公司均已覆盖。</p> <p>OLED 驱动芯片在晶圆测试的时长和对测试机的要求都高于 LCD。另外由于 OLED 芯片高介电层绝缘层的等效氧化物厚度较薄，在凸块制造和研磨切割当中对工艺和设备的要求也要高于 LCD。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023 年 7 月 14 日